

DR ILL CHART							
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE			
<b>♦</b>	0.200 mm		4				
×	1.000 mm		2	NON-PLATED			
+	1.400 mm		2	NON-PLATED			
Ø	2.200 mm		4	NON-PLATED			
	TOTAL	-	12				

## MATERIALE SUPPORTO TIPOLOGIA CIRCUITO SPESSORE RAME ☐ MONOFACCIA ☐ FR2 X LATI ESTERNI X FR4 M DOPPIA FACCIA LATI INTERNI SPESSORE SUPPORTO ALTRO N°LAYERS 2 1 mm TRATTAMENTI RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u ☐PLACC.ELETT. SURFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u ☐PLACC.ELETT. RIFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u RAME PASSIVATO MHOT AIR LEVELING $\square$ DORATURA(D=140±vPN) □0.3u □0.6u □1,0u □1,3u □2,0u BISELLATURA NUMERO DEI CONTATTI DEPOSITO DI GRAFITE NUMERO DEI CONTATTI SOLDER RESIST SERIGRAFIA SERIGRAFICO Sp. XLATO COMP.COLORE BIANCO XLATO SALD. COLORE BIANCO XFOTOGRAFICO Sp. 13-100u

CO	□COVER LAYERSp. 25-76u □							
		EI FORI PARTICO		FILES DI DOCUMENTAZIONE ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE				
TIPO	ø MET.	ø N.MET.	Q.TA'	LAYER BOT	<b>ズ</b> 23-319-0.BOT			
Α				LAYER TOP	<b>ズ</b> 23-319-0.TOP			
В				LAYER PWR				
С				LAYER GND				
D				SERIG. BOT	💢 23-319-0.SSB			
E				SERIG. TOP	<b>X</b> 23-319-0SST			
F				LAYER IN1				
G				LAYER IN2				
Н				LAYER IN3				
I				LAYER IN4				
L				RESIST BOT	💢 23-319-0.SMB			
М				RESIST TOP	💢 23-319-0.SMT			
NC	TE PA	RTICOL	ARI	PAST BOT	💢 23-319-0.SPB			
				PAST TOP	X 23-319-0.SPT			
				LAYER FOR.	×			
				DRILL CHART	X 23-319-0.DRD			
				DRILL TAPE	<b>∑</b> 23-319-0.TAP			
TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO				MECC.DRW.	□PF23-319-0.DWG			
		METALLI	. –					

